

2008年5月13日

2008年3月期 決算説明会

東京エレクトロン デバイス株式会社

2008年3月期 連結業績

(単位:百万円)

	2007年3月期		2008年3月期		増減率 (%)
		百分比%		百分比%	
売上高	99,743	100.0	112,104	100.0	12.4
売上総利益	14,106	14.1	16,957	15.1	20.2
営業利益	3,531	3.5	3,678	3.3	4.2
経常利益	3,245	3.3	3,849	3.4	18.6
当期純利益	1,876	1.9	2,193	2.0	16.9
1株当たり当期純利益	18,957.04円		20,689.48円		
R O E	10.7%		10.5%		
1株当たり年間配当金	6,000円		6,600円		
期末従業員数	739人		788人		

* 2006年10月に東京エレクトロン(株)からコンピュータ・ネットワーク事業を承継いたしました。

2008年3月期 連結資産

(単位:百万円)

科目	2007年3月期	2008年3月期	増減額
現預金	1,142	1,367	224
受取手形・売掛金	23,361	25,633	2,271
たな卸資産	16,888	17,649	761
その他流動資産	1,994	2,354	359
有形固定資産	1,019	1,012	7
無形固定資産	227	785	558
投資その他の資産	2,094	2,654	560
資産計	46,729	51,458	4,728

* 2006年10月に東京エレクトロン(株)からコンピュータ・ネットワーク事業を承継いたしました。

2008年3月期 連結負債・純資産

(単位:百万円)

科目	2007年3月期	2008年3月期	増減額
買掛金	12,888	13,897	1,009
短期借入金	4,351	6,069	1,718
その他流動負債	5,478	5,616	138
固定負債	3,954	4,269	314
負債計	26,673	29,853	3,180
資本金	2,495	2,495	-
資本剰余金	5,645	5,645	-
利益剰余金	11,913	13,438	1,525
評価・換算差額等	1	25	23
純資産計	20,056	21,604	1,548
負債・純資産計	46,729	51,458	4,728

* 2006年10月に東京エレクトロン(株)からコンピュータ・ネットワーク事業を承継いたしました。

2008年3月期 連結キャッシュ・フロー

(単位:百万円)

	2007年3月期	2008年3月期	増減額
営業キャッシュ・フロー	1,654	381	1,273
投資キャッシュ・フロー	401	1,255	854
財務キャッシュ・フロー	902	1,134	2,036
現金及び現金同等物 期末残高	1,142	1,367	224

* 2006年10月に東京エレクトロン(株)からコンピュータ・ネットワーク事業を承継いたしました。

2008年3月期 品目別 連結売上高

(単位:百万円)

品目	2007年3月期		2008年3期		対前年 増減率 (%)
	売上高	構成比 (%)	売上高	構成比 (%)	
半導体製品	79,569	79.8	80,828	72.1	1.6
電子部品他 *1	5,373	5.4	5,296	4.7	1.4
コンピュータ・ネットワーク機器 *2	9,162	9.1	19,520	17.4	113.1
ソフトウェア *3	5,637	5.7	6,459	5.8	14.6
合計	99,743	100.0	112,104	100.0	12.4

*1 従来の「ボード製品」と「一般電子部品」を合算した品目です。

*2 事業承継した品目(2007年3月期は下期のみの実績)で、新たに加わった品目です。

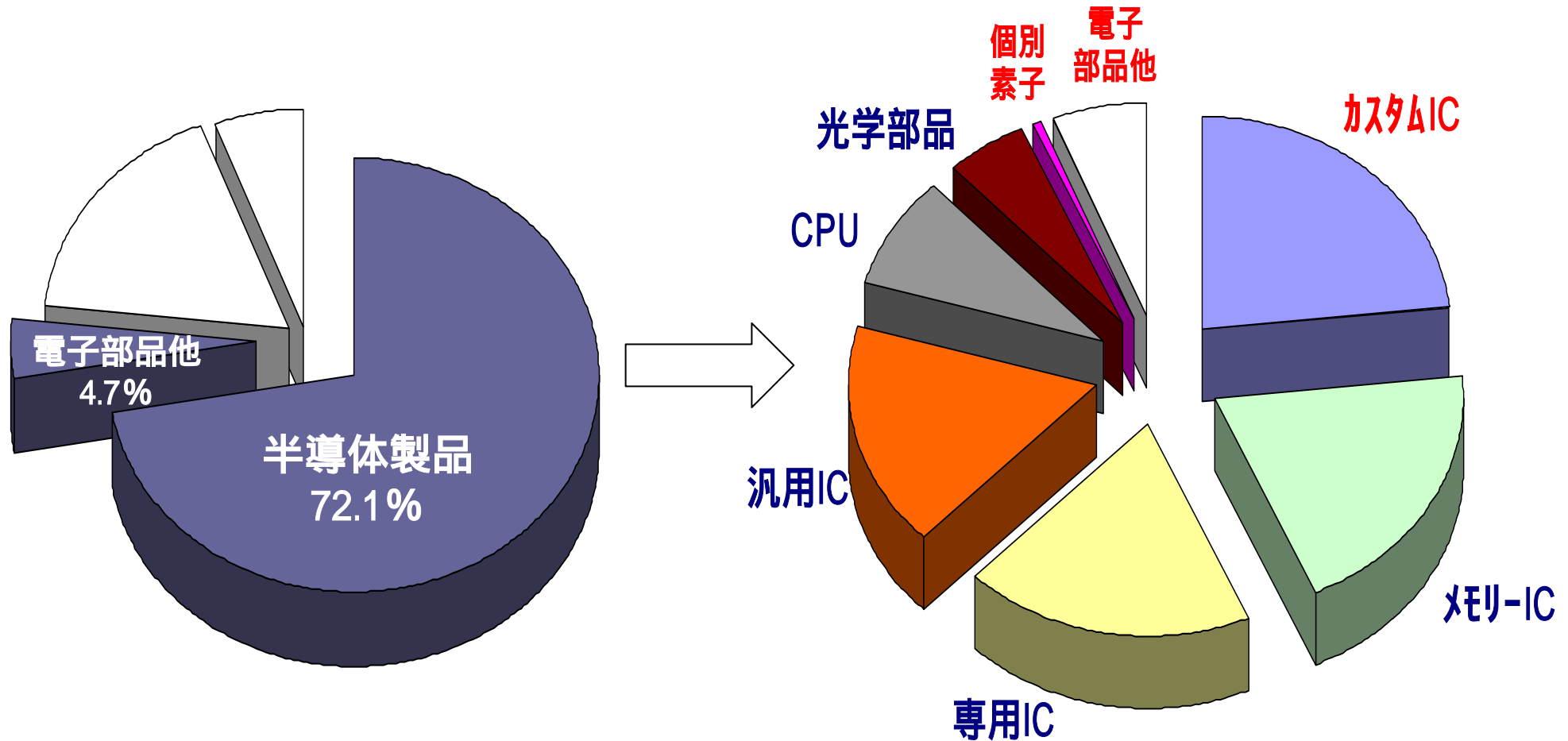
*3 従来のソフトウェアと事業承継したソフトウェア(2007年3月期は下期のみの実績)を合算した品目です。

「半導体・電子部品」について

「半導体・電子部品」売上構成

< 品目別売上構成 >

< 内訳 >

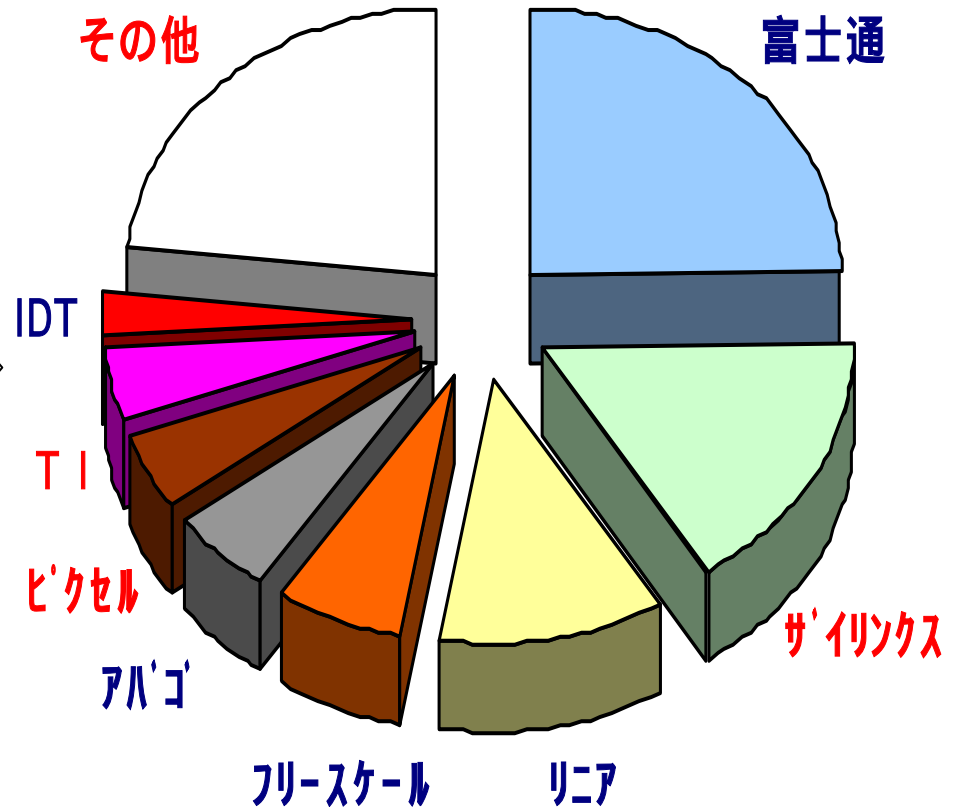
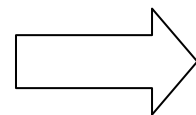
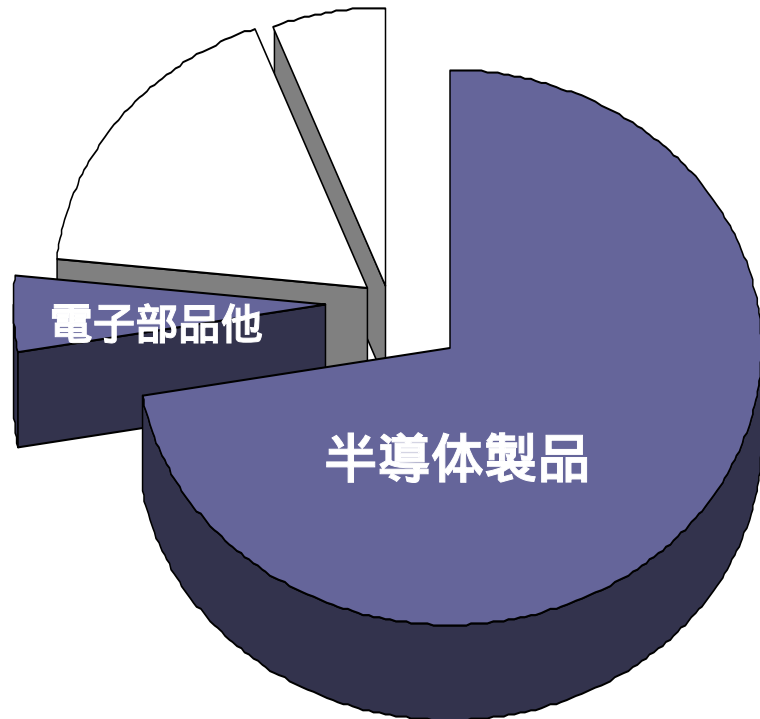


* 品目についての説明は、P.33 ~ P.35をご参照ください。

「半導体・電子部品」商品別売上構成

< 品目別売上構成 >

< 商品別内訳 >



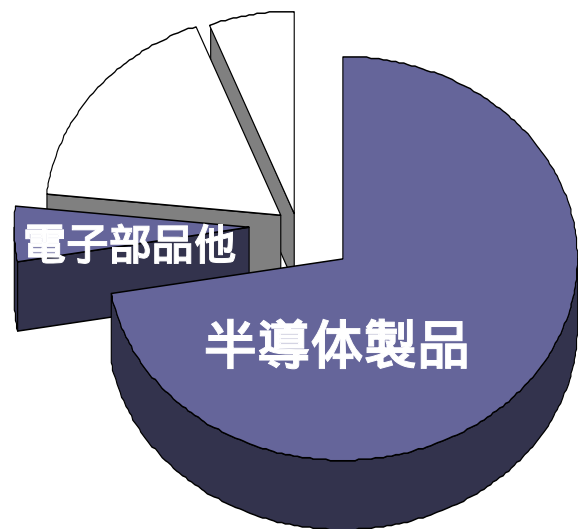
注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

「半導体・電子部品」商品別売上増減要因

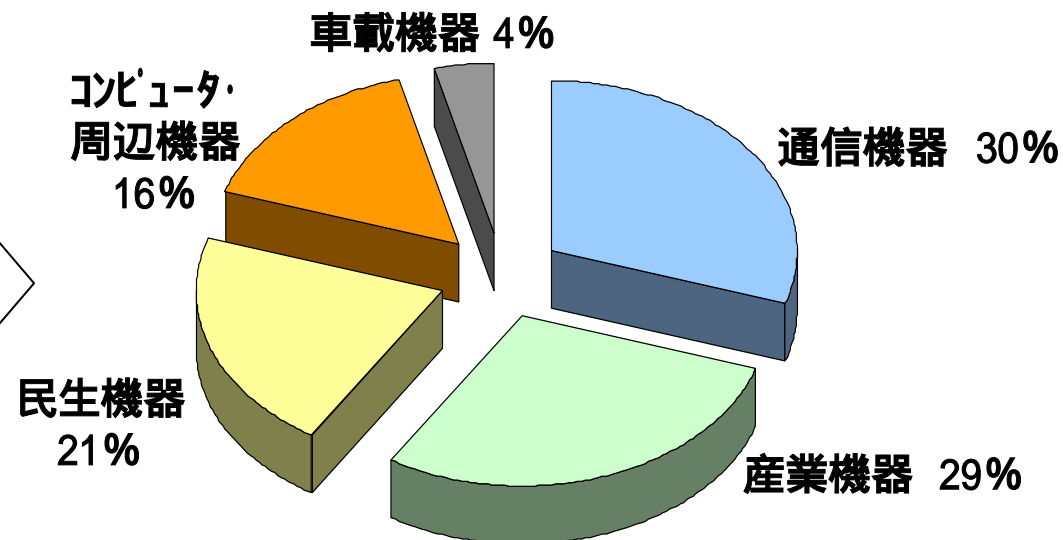
仕入先名	対前年 増減率	要 因
富士通(株)	3%	携帯電話向け伸長
ザイリンクス社	11%	民生機器向け減少
リニアテクノロジー社	6%	全ての分野で伸長
フリースケール・セミコンダクタ社	7%	携帯電話基地局向け、医療機器向け伸長
アバゴ・テクノロジー社	3%	車載向け伸長
ピクセルワークス社	6%	LCDプロジェクタ向け減少
TI社	7%	半導体試験装置、携帯電話基地局向け減少
開発ビジネス	34%	設計受託、自社商品共に伸長

「半導体・電子部品」用途別売上構成

< 品目別売上構成 >



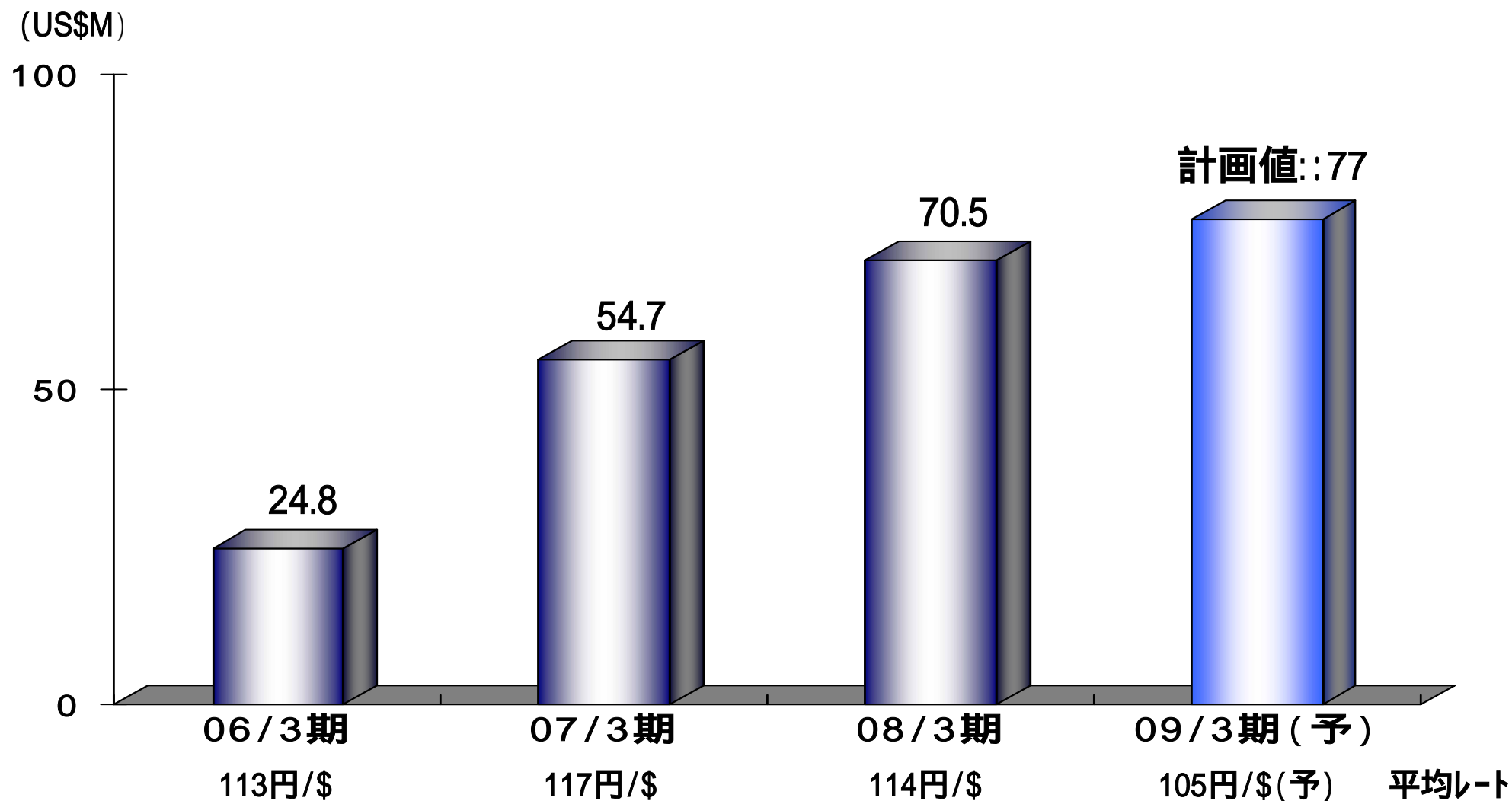
< 用途別内訳 >



用途	主なアプリケーション	主なお客様
通信機器	携帯電話、ルーター、伝送装置、基地局	松下、富士通、日立、NEC他
産業機器	セキュリティ監視機器、医療機器、放送機器、 テスター、半導体製造装置、ロボット、計測器	東芝、松下、アドバンテスト他
民生機器	デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、薄型TV、AV機器	松下、ソニー、ヤマハ、シャープ、他
コンピュータ・周辺機器	プリンター、液晶プロジェクタ、POS、PC及び付属機器	松下、東芝、エプソン、富士ゼロックス他
車載機器	カーナビゲーション、カーオーディオ	松下、三菱、日本精機、アイシン他

注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

「半導体・電子部品」海外連結子会社 売上高推移



「コンピュータ・ネットワーク機器」 「ソフトウェア」について

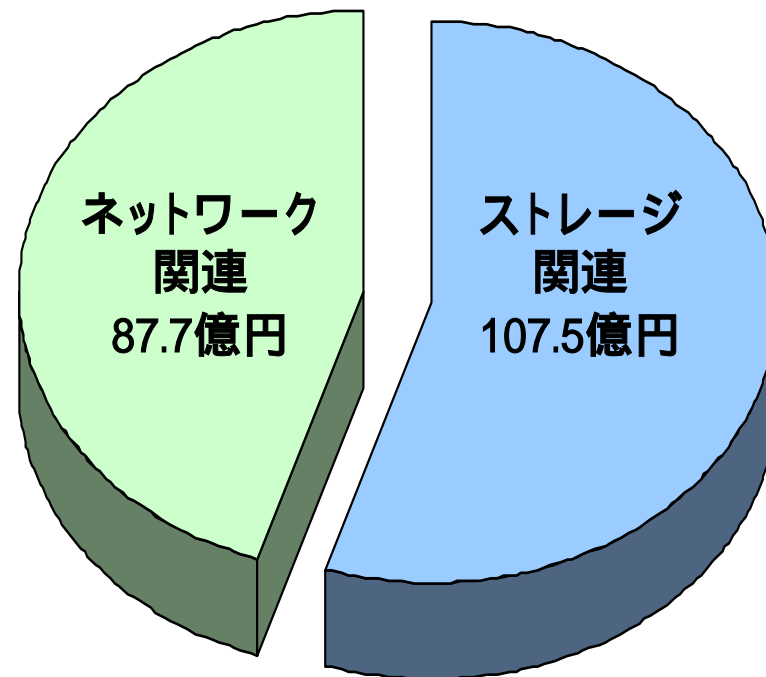
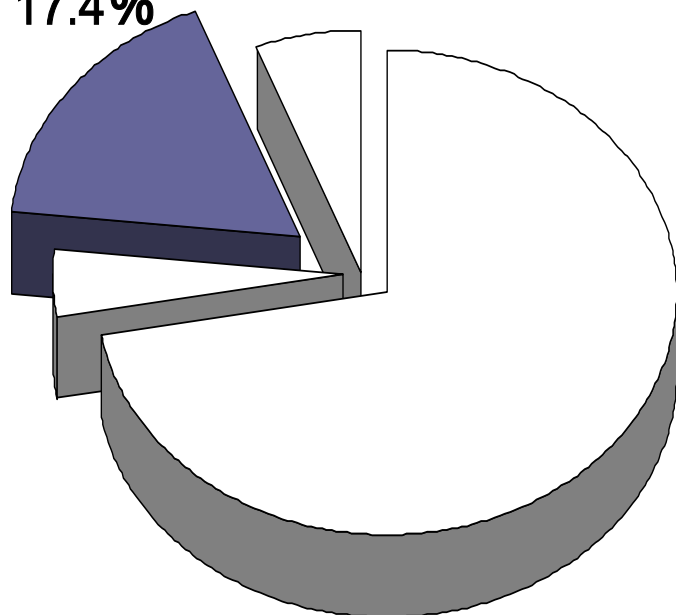
「コンピュータ・ネットワーク機器」分野別売上構成

< 品目別売上構成 >

< 分野別内訳 >

コンピュータ・ネットワーク機器
195億円

17.4%



「コンピュータ・ネットワーク機器」

事業分野	主な用途・機能	主要仕入先
ストレージ関連	SAN(ストレージエリアネットワーク)スイッチ、 SAN接続機器、ストレージセキュリティ機器など	ブロード エミュックス
ネットワーク関連	インターネット接続機器(負荷分散、セキュリティ)、 企業向けネットワークシステム構築機器など	F5ネットワークス エクストリーム



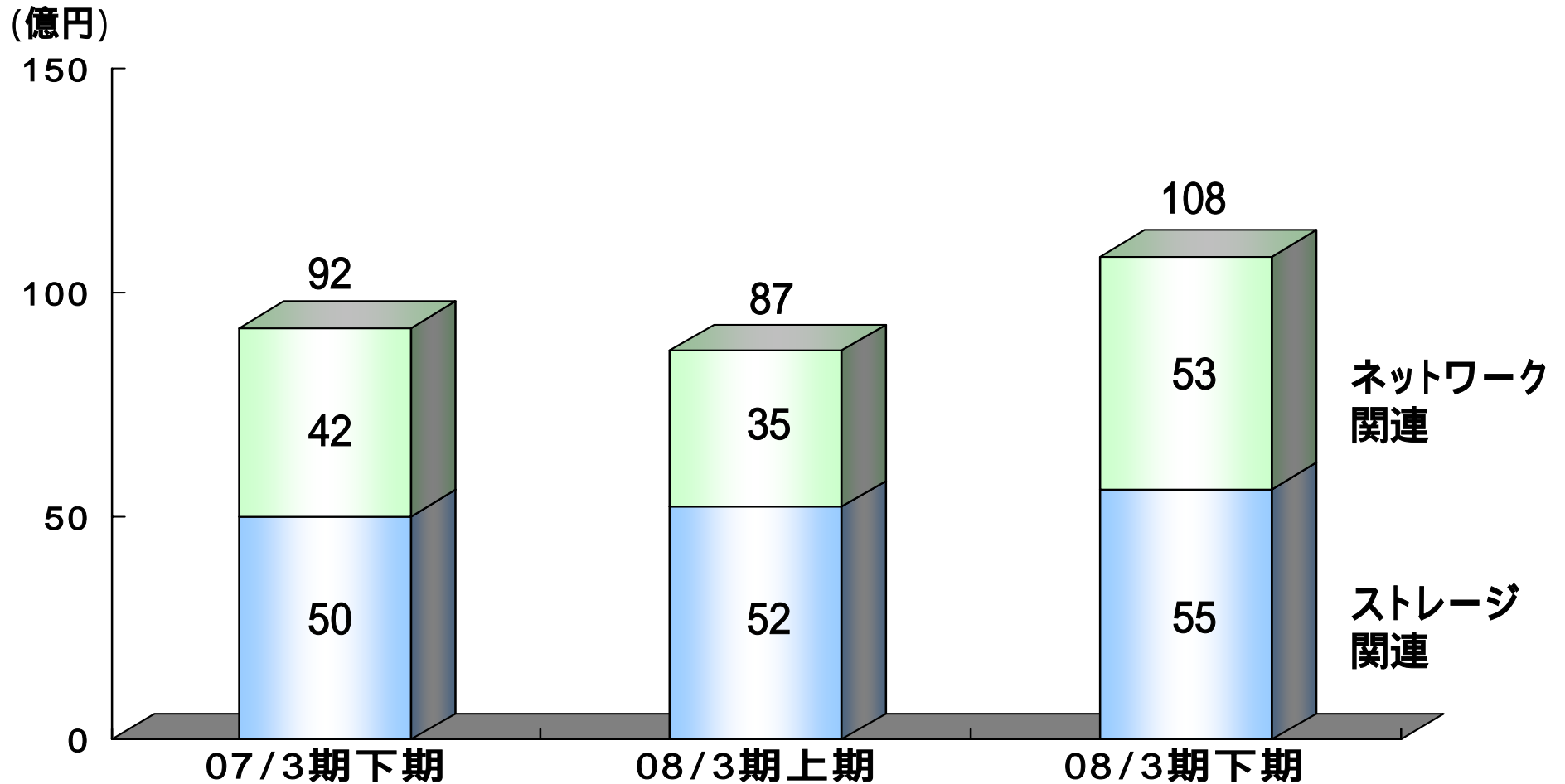
ブロード



F5ネットワークス

注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

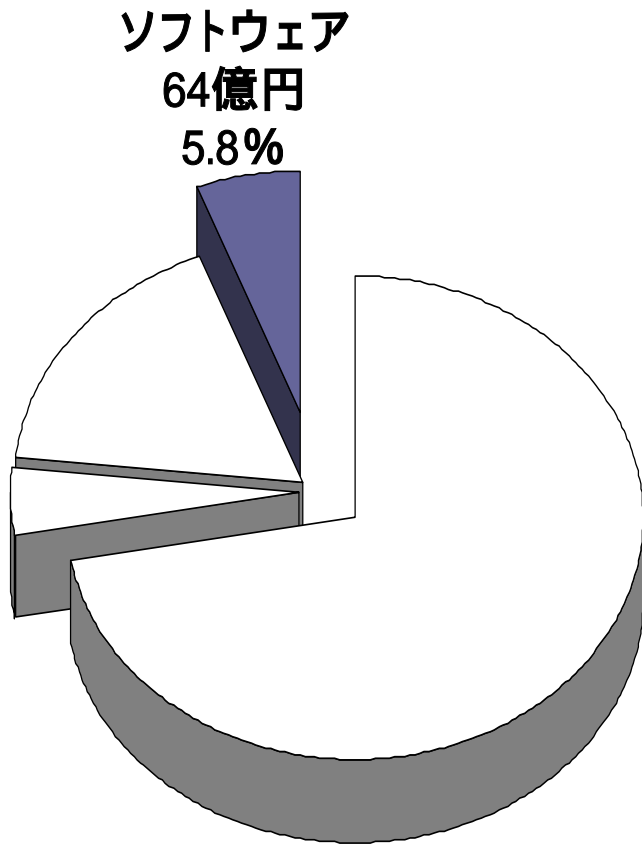
「コンピュータ・ネットワーク機器」 半期毎 売上高推移



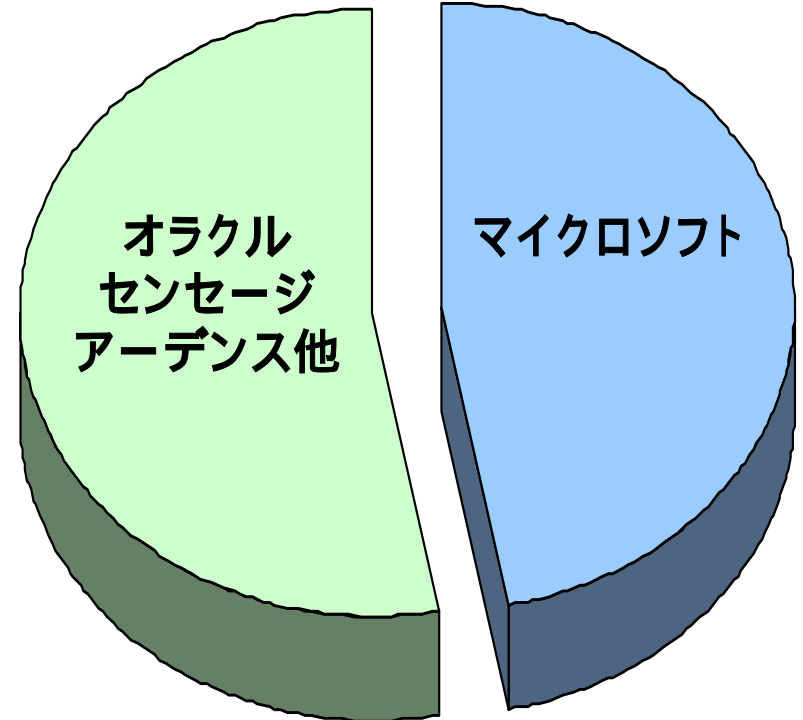
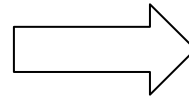
注) コンピュータ・ネットワーク機器は、07/3期下期からの実績となります。

「ソフトウェア」商品別売上構成

< 品目別売上構成 >



< 商品別内訳 >



注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

2008年3月期 トピックス

本社移転決定(11月) 2008年8月移転予定

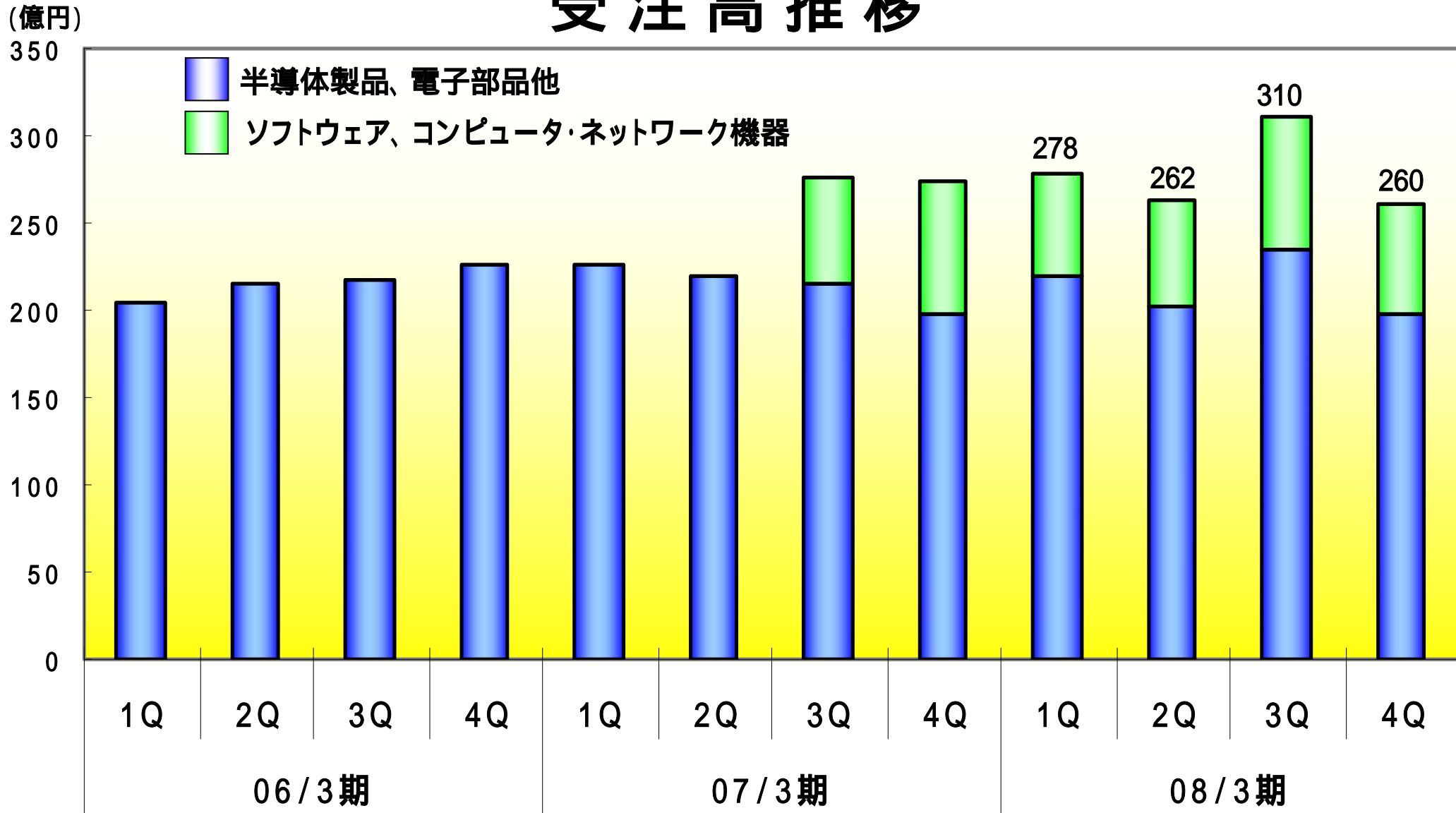
東京エレクトロン デバイス シンガポール
現地法人化(1月)

パネトロン株式会社設立(2月)

厚木サテライトオフィス開設(3月)

今期の業績予想について

受注高推移



注)07/3期3Qより、東京エレクトロン(株)からコンピュータ・ネットワーク事業を承継しております。
07/3期3Qの受注高は、事業承継時(10月)の受注残高41億円を含めておりません。

2009年3月期 当社を取りまく事業環境予想

< 半導体製品、電子部品他 >

- 半導体需要は堅調
- 米国の景気減速による波及
- オリンピック特需の不透明感

< コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア >

- 企業の情報システム投資の一時的減速
- ネットワークのセキュリティ強化は堅調

2009年3月期 品目別 連結売上高予想

(単位:百万円)

品 目	2008年3月期実績		2009年3期見込み		対前年 増減率 (%)
	売上高	構成比 (%)	売上高	構成比 (%)	
半導体製品	80,828	72.1	83,700	72.8	3.6
電子部品他	5,296	4.7	5,300	4.6	0.1
コンピュータ・ネットワーク機器	19,520	17.4	19,500	17.0	0.1
ソフトウェア	6,459	5.8	6,500	5.6	0.6
合 計	112,104	100.0	115,000	100.0	2.6

2009年3月期 連結業績予想

(単位:百万円)

	上期予想	下期予想	通期予想	対前年 増減率 (%)
売上高	54,600	60,400	115,000	2.6
営業利益	1,560	2,745	4,305	17.0
経常利益	1,410	2,610	4,020	4.4
当期純利益	715	1,495	2,210	0.8
1株当たり配当金	3,300円	3,300円	6,600円	-

2009年3月期の活動方針

1. 半導体製品、電子部品他

- 産業機器分野への販売強化
- 海外事業展開の推進

2. コンピュータ・ネットワーク機器

- インテグレーションビジネスの推進

3. ソフトウェア

- セキュリティ分野向け拡販

4. 開発ビジネス(インレピアム)

中期計画

< 2011年3月期 >

売上高

1,500億円

経常利益

75億円

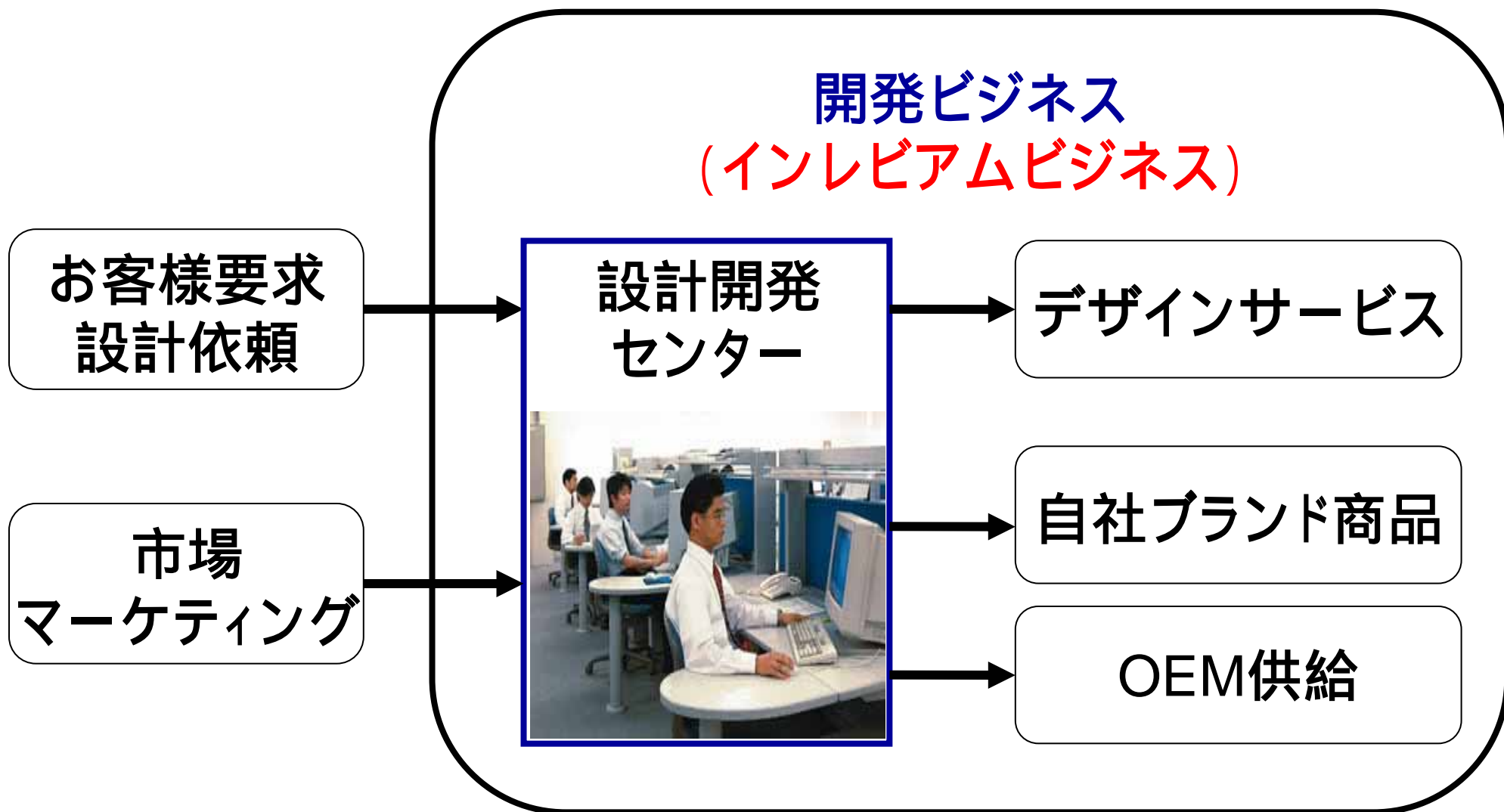
売上高経常利益率

5%

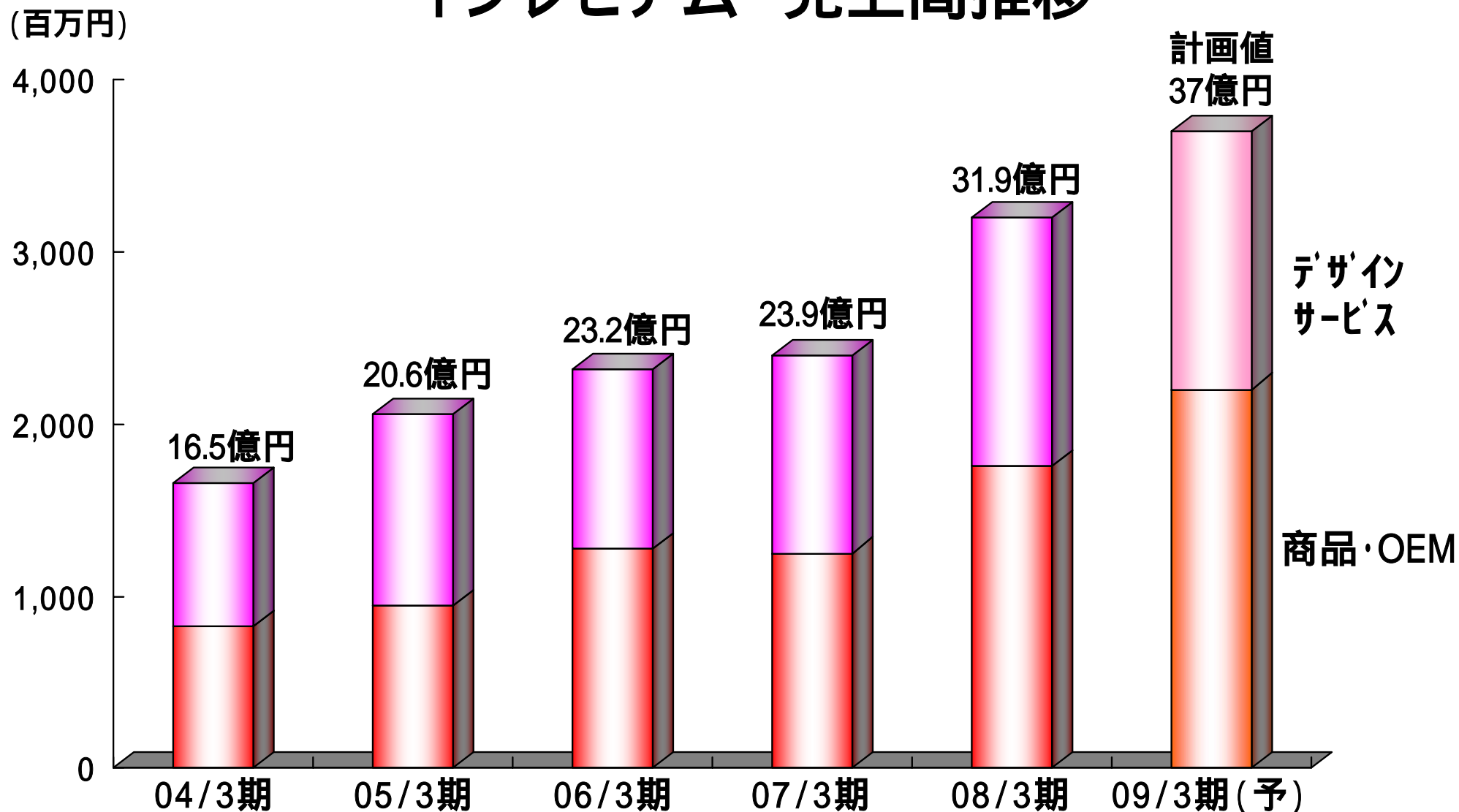
開発ビジネスについて

inrevium
(インレビウム)

高付加価値事業への取組み



インレビウム 売上高推移

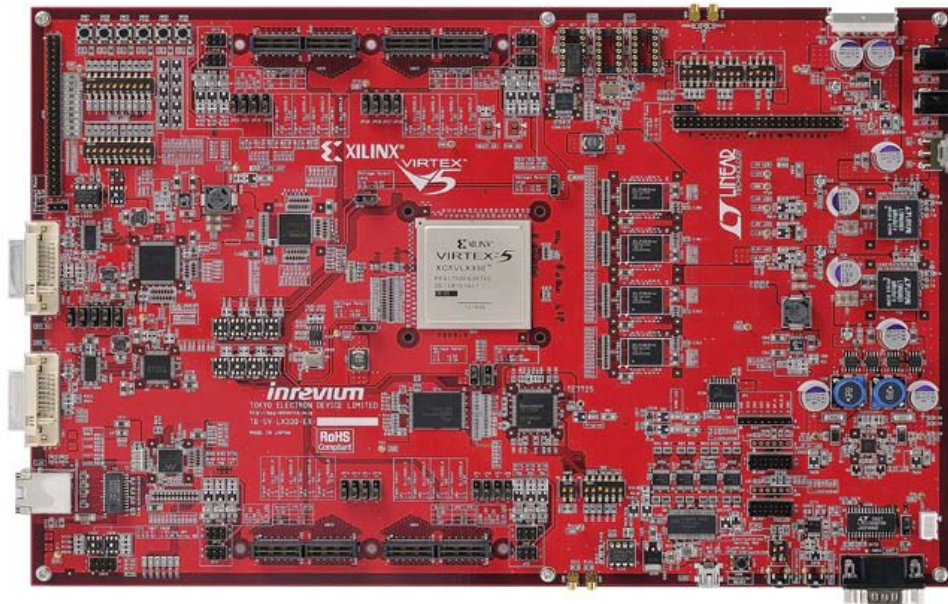


注)06/3期より連結決算を開始しており、06/3期以降は、連結売上高を記載しております。

インレビウム商品 開発例

LSI開発支援用評価ボード

- ザイリンクス社FPGA (Virtex-5) と高速メモリを搭載
- LSI開発の期間短縮、費用削減に効果を発揮
- 2008年3月発売開始



TB-5V-LX330-EX

< 主な応用分野 >
薄型TV、DVDなどの
デジタル家電用LSI開発ツール

インレビウム商品 開発例

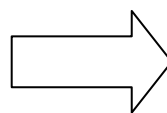
映像機器用LSI

- 動き対応型、斜め線補正機能により、高画質に変換
- 監視カメラなどの映像機器向け
- 2008年3月開発完了、4月発売開始



TE3450RPF

< 当社開発 LSI 使用時 >



開発ビジネス 活動方針

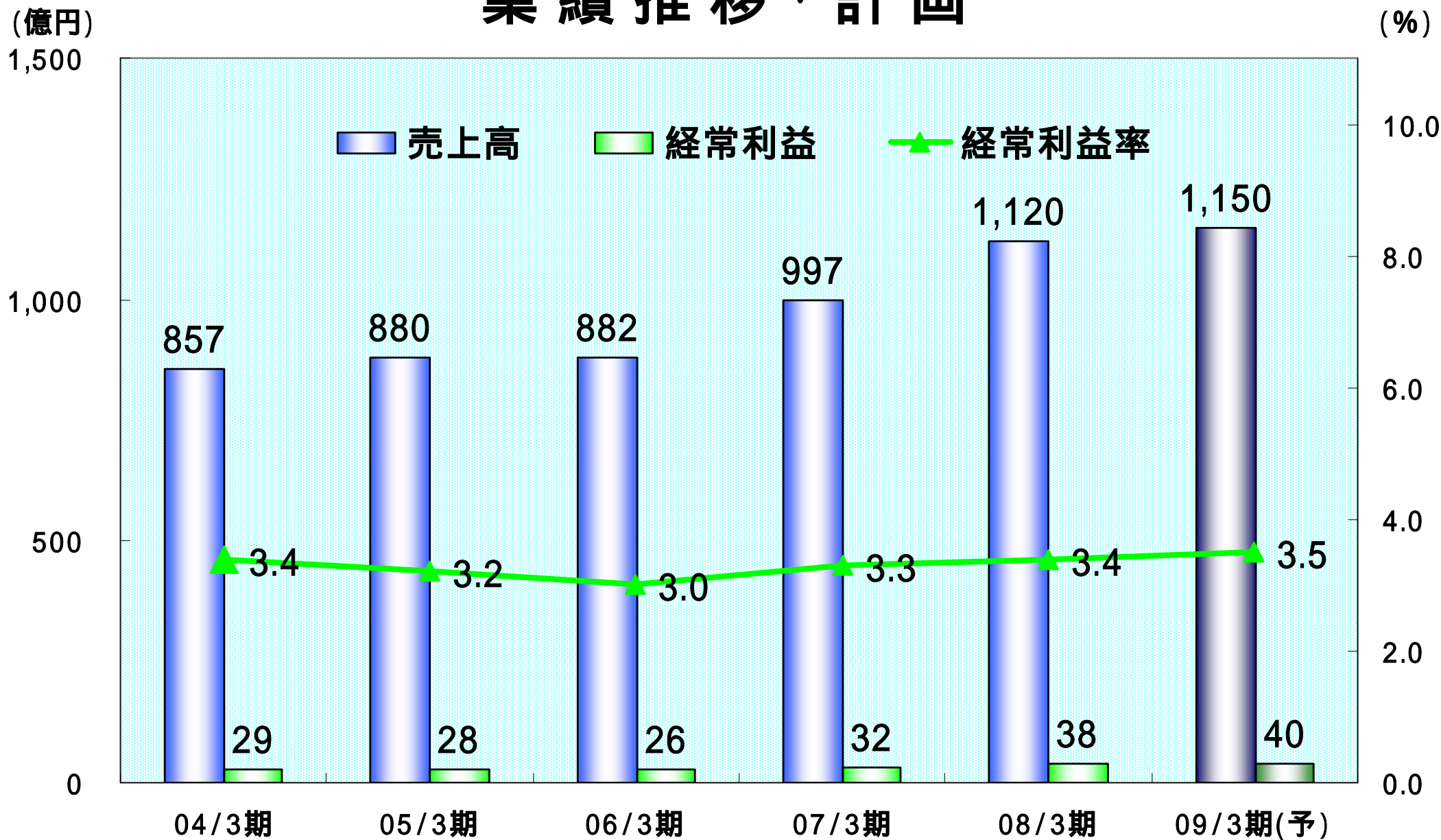
デザインサービス

- 自社ブランド商品への展開
- OEM供給の拡大
- ソフトウェアの取込み強化

自社商品

- 新規商品の拡充
- 海外市場への展開

業績推移・計画



品目別仕入先名

	品目	主な仕入先名
半導体製品	カスタムIC	富士通エレクトロニクス(株)、ザ・リンクス社
	メモリーIC	富士通エレクトロニクス(株)、IDT社、ラムロンインターナショナル社
	専用IC	コネクサントシステムズ社、フリースケール・セミコンダクタ社、富士通エレクトロニクス(株)、IDT社、ピクセルワークス社、ザ・リンク・セミコンダクター社、インビーム
	汎用IC	リニアテクノロジー社、オン・セミコンダクター社、TI社
	CPU	フリースケール・セミコンダクタ社、富士通エレクトロニクス(株)、TI社
	光学部品	アバゴ・テクノロジー社
	個別素子	オン・セミコンダクター社
電子部品他	コーセル(株)、(株)デジタル、ダイアロジック社、インビーム	
コンピュータ・ネットワーク機器	エクストリーム ネットワークス社、F5 ネットワークス社、ブロード コミュニケーションズ システムズ社、エミュレックス社	
ソフトウェア	マイクロソフト社、日本オラクル(株)、センセージ社、インビーム	

用語説明(1)

半導体製品	主な取扱商品	機能
カスタムIC	ASIC(富士通エレクトロニクス株) PLD(ザイリンクス社)	お客様の仕様に応じて作られる固有IC
メモリーIC	DRAM、SRAM フラッシュメモリ	記憶用IC、書込み、読出しが可能なものや 読出しのみのものがある
専用IC	画像処理用IC 通信用・ネットワーク用IC	特定用途用に作られた専用IC
汎用IC	汎用リアIC(アナログIC) 汎用ロジックIC	色々な用途に共通に使用されるIC
CPU	マイクロプロセッサ、DSP	電子機器の頭脳、演算機能・制御機能
光学部品	発光ダイオード、フォトグラフ	電気を光に変換して使用する電子部品
個別素子	整流素子、トランジスタ	増幅、整流などの機能を持つ部品

用語説明(2)

<p>電子部品他</p>		<p>プリント配線基板上にIC、電源、コネクタなどの部品を実装したボード製品、 機器間を接続するコネクタやケーブル、電源などの電子機器には不可欠な周辺部品。</p>
<p>コンピュータ・ネットワーク機器</p>		<p>インターネット接続機器(負荷分散、セキュリティ)、 企業向けネットワークシステム構築機器、 SAN(ストレージエリアネットワーク)スイッチ、 SAN接続機器、ストレージセキュリティ機器など。</p>
<p>ソフトウェア</p>		<p>セキュリティ用ログ長期保存・分析ミドルウェア、 企業向け産業機器に組み込まれるマイクロソフト社のOSなどのソフトウェア。</p>

資料取扱い上の注意

このプレゼンテーションで述べられている将来の当社事業に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに構築されたものです。

当社の参画するエレクトロニクス業界は変化のスピードが大変速く、また、世界経済、半導体市況など、当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。

したがって、今後当社の業績見通しが本プレゼンテーションと異なる可能性があることをお含みおきください。また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。